

## 广州方邦电子股份有限公司

### 关于自愿性披露子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示:

● 投资标的名称: 广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州穗邦电子有限公司（以下简称“穗邦电子”）拟通过受让股权的方式获得深圳中科四合科技有限公司（以下简称“中科四合”或“目标公司”）1.06859%股权。

● 投资金额: 自有资金人民币 2,000 万元。

● 本次投资已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项无需提交股东会审议。

● 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示: 目标公司的实际经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。本次投资不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

基于战略规划考虑与公司重点产品带载体可剥离超薄铜箔（以下简称“可剥铜”）等高端铜箔的业务发展需要，公司的全资子公司穗邦电子与苏州清石晶晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清石晶晟”）及中科四合近日拟签

署相关转让协议，经交易各方友好协商一致确定，穗邦电子拟以人民币 2,000 万元收购清石晶晟持有的中科四合 1.06859% 股权（对应注册资本 11.25508 万元），本次交易完成后，穗邦电子对中科四合的持股比例为 1.06859%，中科四合将成为公司全资子公司穗邦电子的参股公司。

（二）对外投资的决策和审批程序

2026 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于子公司对外投资的议案》，全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）目标公司基本情况

企业名称	深圳中科四合科技有限公司
统一社会信用代码	9144030031945352X9
成立日期	2014/10/30
注册地址	深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑观光路 1310 号厂房 2 栋 501
法定代表人	黄冕
注册资本	1,053.26066 万元
经营范围	一般经营项目：电子产品、电子元器件、集成电路、功率器件、传感器、电路板的研发、销售；计算机软硬件的技术开发、销售；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：电子元器件、集成电路、功率器件、传感器的生产

中科四合最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	45,730.43	47,013.86
负债总额	27,658.49	27,765.83

项目	2025年12月31日	2025年9月30日
净资产	18,071.94	19,248.03
	2025年度	2025年1-9月
营业收入	12,621.84	9,330.70
净利润	-11,424.41	-8,248.33
扣除非经常性损益后的净利润	-12,947.33	-9,367.81

注：财务数据未经审计。

截至本公告披露日，目标公司未被列入失信被执行人，与公司及其控股股东和实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系及利益安排，未直接或间接持有公司股份。

## （二）目标公司的股权结构

本次交易前股权结构：

股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
四合知行（深圳）投资咨询合伙企业（有限合伙）	233.97364	22.2142%
四合共赢（深圳）投资咨询合伙企业（有限合伙）	123.2	11.6970%
黄冕	101.2	9.6083%
义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）	89.30971	8.4794%
义乌韦豪创芯一期股权投资合伙企业（有限合伙）	56.43361	5.3580%
厦门半导体投资集团有限公司	54.5453	5.1787%
广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	47.71966	4.5307%
广西泰达新原股权投资有限公司	41.19608	3.9113%
广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）	35.30595	3.3521%
嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有限合伙）	32.11209	3.0488%
北京中科微知识产权服务有限公司	31.4815	2.9890%
杭州芯岚微创业投资合伙企业（有限合伙）	31.4815	2.9890%
四合绘景（厦门）投资咨询合伙企业（有限合伙）	30.13355	2.8610%
广西华清华和投资合伙企业（有限合伙）	25.68967	2.4391%
中科金醇（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙）	20.17181	1.9152%
合肥中合智能汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	19.26726	1.8293%
北京远京投资基金中心（有限合伙）	16.03869	1.5228%
苏州清石晶晟创业投资合伙企业（有限合伙）	12.84484	1.2195%
珠海先进一期集成电路股权投资基金（有限合伙）	10.69246	1.0152%

股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例
丁鲲鹏	8.8	0.8355%
无锡彬复海创人才创业投资合伙企业（有限合伙）	7.95328	0.7551%
嘉兴骅赛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6.42242	0.6098%
海南泰达创业投资基金有限公司	6.42242	0.6098%
佛山任君瀚远股权投资合伙企业（有限合伙）	5.34623	0.5076%
佛山博科金铎创业投资合伙企业（有限合伙）	5.34623	0.5076%
广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）	0.1193	0.0113%
北京京国创创辉股权投资中心（有限合伙）	0.05346	0.0051%
<b>合计</b>	<b>1,053.26066</b>	<b>100.0000%</b>

本次交易后股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
四合知行（深圳）投资咨询合伙企业（有限合伙）	233.97364	22.2142%
四合共赢（深圳）投资咨询合伙企业（有限合伙）	123.2	11.6970%
黄冕	101.2	9.6083%
义乌华芯远景创业投资中心（有限合伙）	89.30971	8.4794%
义乌韦豪创芯一期股权投资合伙企业（有限合伙）	56.43361	5.3580%
厦门半导体投资集团有限公司	54.5453	5.1787%
广东省半导体及集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	47.71966	4.5307%
广西泰达新原股权投资有限公司	41.19608	3.9113%
广州华芯盛景创业投资中心（有限合伙）	35.30595	3.3521%
嘉兴天府骅胜股权投资合伙企业（有限合伙）	32.11209	3.0488%
北京中科微知识产权服务有限公司	31.4815	2.9890%
杭州芯岚微创业投资合伙企业（有限合伙）	31.4815	2.9890%
四合绘景（厦门）投资咨询合伙企业（有限合伙）	30.13355	2.8610%
广西华清华和投资合伙企业（有限合伙）	25.68967	2.4391%
中科金醇（苏州）创业投资合伙企业（有限合伙）	20.17181	1.9152%
合肥中合智能汽车产业投资合伙企业（有限合伙）	19.26726	1.8293%
北京远京投资基金中心（有限合伙）	16.03869	1.5228%
广州穗邦电子有限公司	11.25508	1.0686%
珠海先进一期集成电路股权投资基金（有限合伙）	10.69246	1.0152%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
丁鲲鹏	8.8	0.8355%
无锡彬复海创人才创业投资合伙企业（有限合伙）	7.95328	0.7551%
嘉兴骅赛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6.42242	0.6098%
海南泰达创业投资基金有限公司	6.42242	0.6098%
佛山任君瀚远股权投资合伙企业（有限合伙）	5.34623	0.5076%
佛山博科金铎创业投资合伙企业（有限合伙）	5.34623	0.5076%
苏州清石晶晟创业投资合伙企业（有限合伙）	1.58976	0.1509%
广州创盈健科投资合伙企业（有限合伙）	0.1193	0.0113%
北京京国创创辉股权投资中心（有限合伙）	0.05346	0.0051%
<b>合计</b>	<b>1,053.26066</b>	<b>100.0000%</b>

### 三、投资方式

穗邦电子拟以自有资金 2,000 万元收购清石晶晟持有的中科四合 1.06859% 股权（对应注册资本 11.25508 万元），本次交易完成后，穗邦电子对中科四合的持股比例为 1.06859%，中科四合将成为公司全资子公司穗邦电子的参股公司。

### 四、股权转让协议的主要内容

甲方（转让方）：苏州清石晶晟创业投资合伙企业（有限合伙）

乙方（受让方）：广州穗邦电子有限公司

丙方（目标公司）：深圳中科四合科技有限公司

本协议各方经协商一致同意，转让方将其持有目标公司注册资本 11.25508 万元以 2,000 万元的价格转让给受让方。

转让方确认和承诺：（1）转让方对标的股权拥有真实、完全和合法的所有权，转让方已按时足额履行标的股权所对应的全部实缴出资义务，受让方对标的股权不再负有任何出资义务；（2）标的股权不存在被质押、被查封或者被冻结等任何权利负担以及可能影响受让方对标的股权所有权现实或潜在的诉讼、仲裁、行政处罚等事项。

目标公司应协助并促使目标公司其他现有股东协助投资方完成本次股权转让有关的行政审批（如有）、工商变更登记及其他必要法律手续。

### 五、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资中科四合，是公司进一步完善和提升产业布局的举措，符合公

司总体发展战略要求，对公司的业务布局和产业协同具有一定的促进作用。

目标公司是国产板级封装（PLP）领军企业，PLP 是下一代先进封装技术，可容纳超大尺寸芯片与多芯片组合，支持逻辑芯片、存储、传感器、功率器件等不同工艺、不同尺寸的裸晶高密度集成，较当前主流的 WLP(Wafer level Package) 技术可较大幅提升面板封装利用率并降低生产成本，同时可实现更薄的封装厚度，缩短芯片互连路径，降低信号传输损耗与寄生参数，提升信号完整性与高频性能，降低器件功耗，适配当前高算力、高性能 AI 芯片的异构集成需求。

公司与目标公司的业务具有一定的协同性。可剥铜是公司的战略性产品，是先进芯片封装的关键基础材料；目标公司作为板级先进封装企业，对可剥铜有使用需求，且在芯片封装行业拥有相关客户资源。通过加强与目标公司的合作，有利于整合双方产业资源，加快公司可剥铜产品在相关客户的验证、导入及市场开拓进程，从而提升公司经营业绩和核心竞争力。

本次对外投资以公司自有资金投入，是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、对外投资的风险分析

### 1、研发迭代及市场开拓风险

目标公司主要从事 PLP 产品的研发、生产和销售，相关产品已实现产业化并形成一定客户基础。PLP 是下一代先进封装技术，技术门槛较高，需要持续进行研发攻关、产品迭代升级、下游验证及市场拓展等一系列工作，技术更新较快、研发投入较大、研发周期较长，因此存在一定不确定性。另外，随着行业竞争加剧和下游需求变化，如目标公司不能持续推出契合市场需求且具备竞争力的产品，并不断扩大市场份额，可能导致目标公司竞争力下降，影响目标公司后续发展，存在公司本次投资收益不及预期的风险。

### 2、持续经营风险

芯片先进封装行业具有较强的人才密集、技术密集和资金密集特征，产品研发、工艺优化、市场开拓及业务拓展均需要持续的资金投入。目标公司后续如不能通过自身经营发展或外部融资持续获取资金支持，可能面临经营发展不及预期等风险，进而影响目标公司的核心竞争力和可持续发展能力。

### 3、业务协同效应不达预期的风险

目标公司与公司的可剥铜等高端铜箔业务具有一定的协同性。但合作过程中，可能因双方在企业文化、管理风格、利益关注点或决策机制等方面的差异，导致协同进度滞后或效果打折。此外，市场环境变化、行业竞争加剧或公司在目标公司持股比例较低、具体合作项目执行不及预期等因素，也可能对协同目标构成挑战。

### 4、投资不达预期的风险

若未来因行业环境变化、技术创新及产品迭代无法满足市场需求等因素，导致目标公司经营状况严重恶化，根据相关会计准则，公司需对本次投资计提公允价值变动损失，直接侵蚀当期利润。

特此公告。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2026年3月12日